

株式会社 TMH

2024年11月期 通期決算説明資料

東証グロース市場・福証Q-Board市場：280A

2025年1月14日

株主の皆さまへ

代表取締役社長 榎並大輔



半導体市場は、AIの進化、量子コンピュータ、IoTといった技術革新を牽引役に、驚異的な成長を遂げています。その市場規模は2030年には1兆ドルに達するとも予測されており、世界経済や産業の根幹を支える重要な分野であることは言うまでもありません。

こうした中、世界中の半導体工場が稼働を続け、半導体製造装置の累積台数が増えるほど、当社が属する半導体製造アフターマーケット市場も着実に拡大していくと考えています。

当社は、エンジニアリングとデジタル化（プラットフォーム）の両面から半導体工場のサプライチェーンを支え、工場の安定稼働に貢献してまいりました。私たちは、日本の半導体産業、ひいては日本のものづくりの復権に貢献するという強い使命感を持って活動しています。半導体産業が日本の産業競争力を再び世界に示す原動力となるよう、挑戦を続けてまいります。今後とも、当社の挑戦と成長にご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新たなプラットフォームとして半導体人材特化型プラットフォームを2024年12月にローンチ
今後の利益成長戦略の重要テーマとして投資を継続

エンジニアリング力を活かした装置販売ビジネスが拡大し、トップラインが伸長

2024年11月期
実績

	実績	前年比 (FY2023対比)
1 売上高	6,017 百万円	+244 %
2 営業利益	323 百万円	+450 百万円
3 営業利益率	5.4 %	前年度△7.3%から+5.4%となり、大幅に改善

シェア拡大を狙いとしてトップライン拡大

2025年11月期
業績予想

	計画	前年比 (FY2024対比)
1 売上高	7,871 百万円 ~ 8,366 百万円	~ +39 %
2 営業利益	296 百万円 ~ 366 百万円	~ +13 %
3 営業利益率	3.8 % ~ 4.4 %	~ △1 %

AGENDA

- 01** **当社事業の概要**
- 02** **2024年11月期 通期業績ハイライト**
- 03** **2025年11月期 通期業績予想**

Appendix

LAYLA-HRについて

01 当社事業の概要

AGENDA

- 01 会社概要
- 02 事業内容
- 03 市場環境
- 04 競争優位性
- 05 成長戦略

会社概要

会社名 株式会社TMH

代表取締役社長 榎並 大輔

所在地 大分県大分市下郡北3-14-6

設立 2012年3月9日

従業員数 39名（2024年11月末時点）

資本金 1億円（2024年11月末時点）

事業内容 半導体製造フィールドソリューション事業
（装置・部品の販売・修理、越境ECサイト
LAYLA-ECの運営）

事業所 大分本社・中部支店・関東支店
・東北出張所・九州支店（熊本）

全国 **5拠点** に展開



マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



榎並大輔 Taisuke Enami
代表取締役
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。
創業以来連続増収を実現。
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



香月賢一 Kenichi Katsuki
取締役 COO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



関真希 Maki Seki
取締役 CFO

大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画



野木村修 Osamu Nogimura
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事



半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

領域

巨大な
半導体業界

提供する価値

半導体製造装置の延命
メンテナンスコストの軽減

特徴

ニッチトップ
かつ
高成長

当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

調達課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー半導体製造装置**が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

製造課題

- IoT（Internet of Things）により急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

物流課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

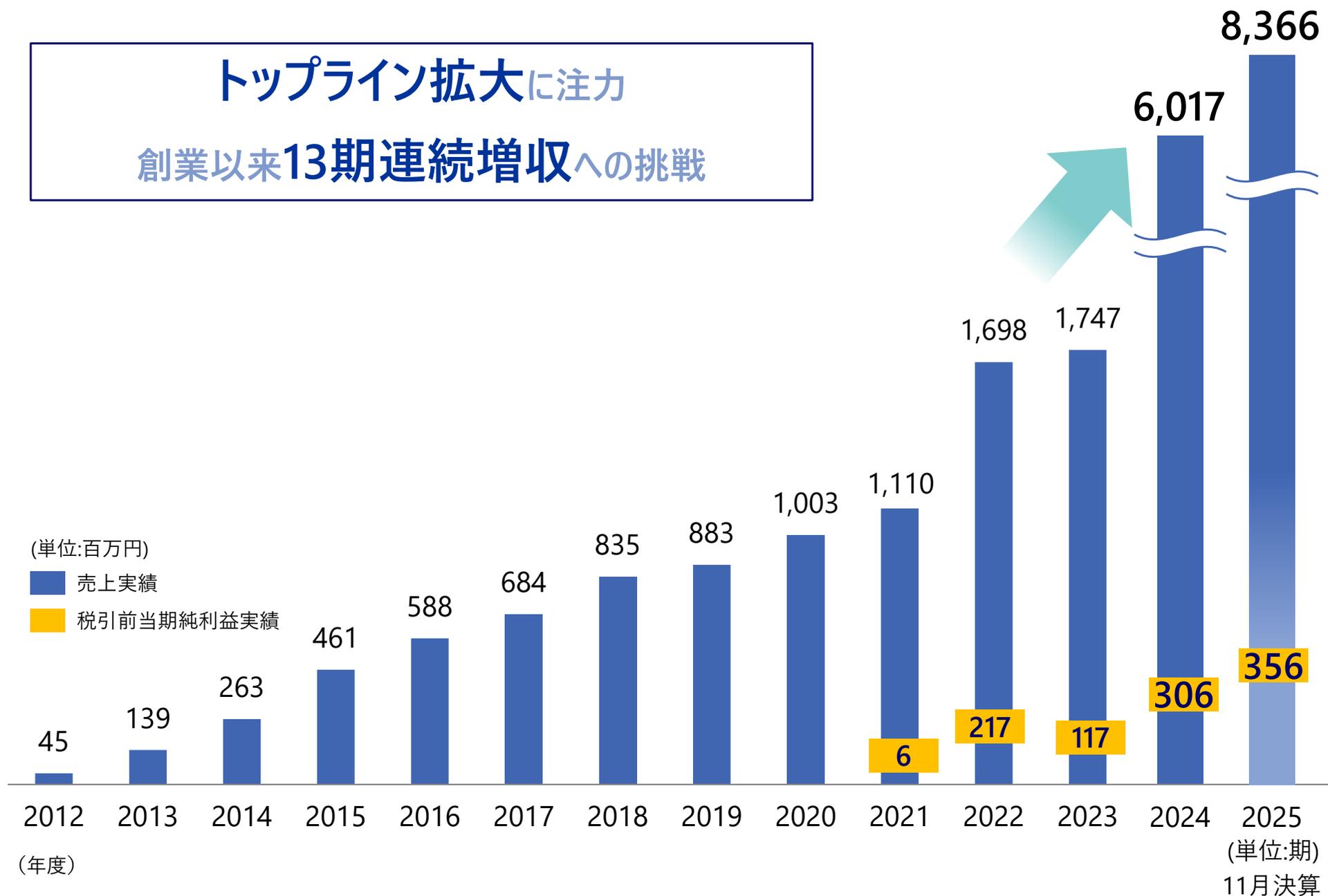
当社が目指す未来

半導体製造に関する多様な課題を解決し、
日本のものづくりの復権を支えます

業績推移

トップライン拡大に注力し、アフターマーケット市場のリーディングカンパニーとしての地位を確立を目指す

トップライン拡大に注力
創業以来13期連続増収への挑戦



AGENDA

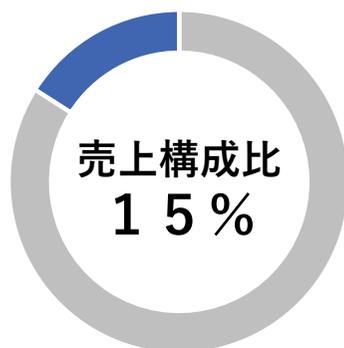
- 01 会社概要
- 02 事業内容
- 03 市場環境
- 04 競争優位性
- 05 成長戦略

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の概要～ トータルソリューションの提供により、半導体工場の稼働を支援

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

1 越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用



【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

【実績】

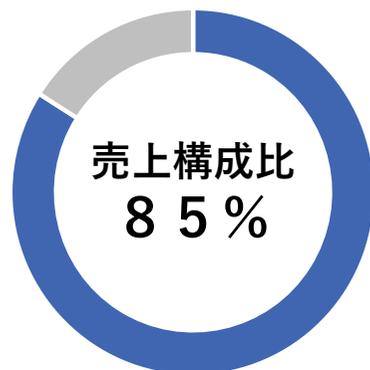
- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 31.5万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



2024年11月期実績

2 エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

- ✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）



2024年11月期実績

ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

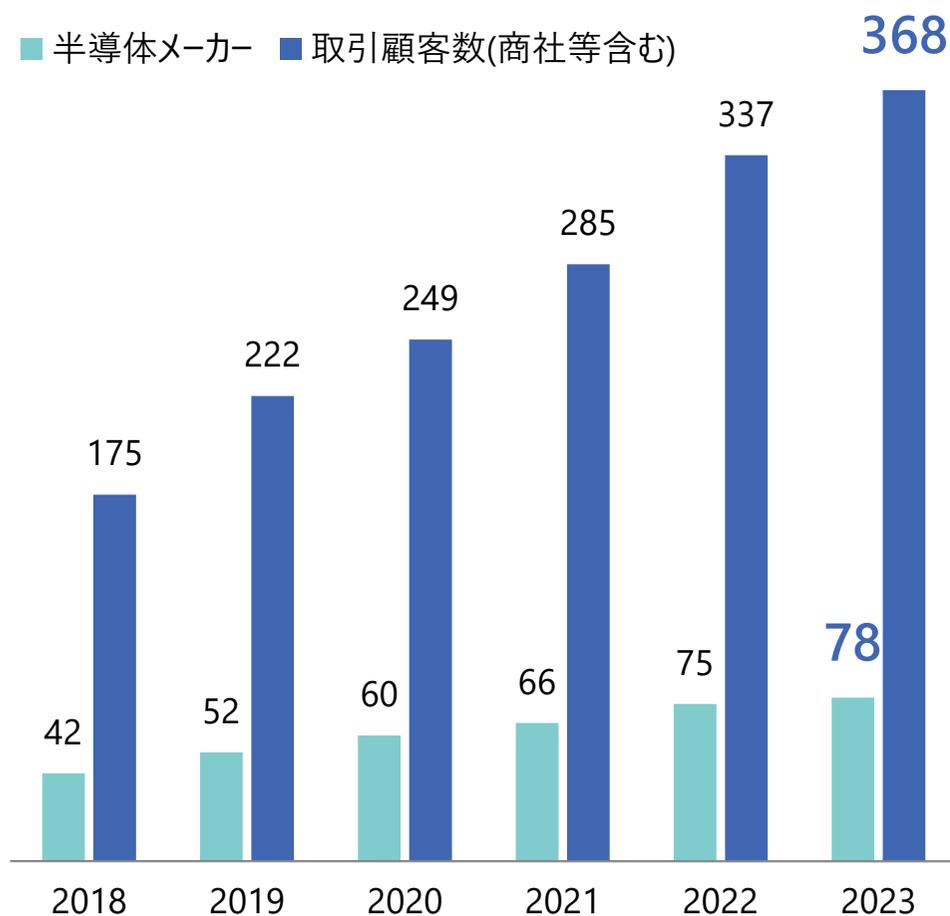


顧客

越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 顧客数は半導体メーカー（拠点数）で70拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で300社超
- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引
- 越境ECサイト「LAYLA-EC」の展開も加わり、海外半導体メーカーとの取引も拡大し売上拡大に寄与

顧客数推移



2023年度11月実績

国別クライアントマップ



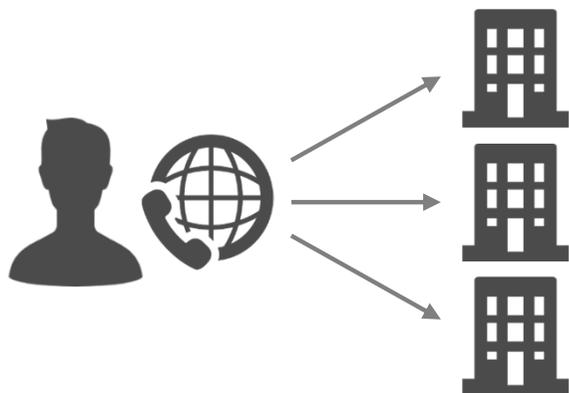
取引実績

- キオクシア
- テキサスインスツルメンツ
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ルネサスエレクトロニクス
- SUMCOグループ
- 東芝グループ
- ラピス 他

LAYLAが提供する価値 世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

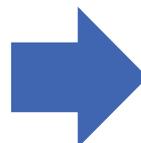
- 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、
半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供

従来の調達方法



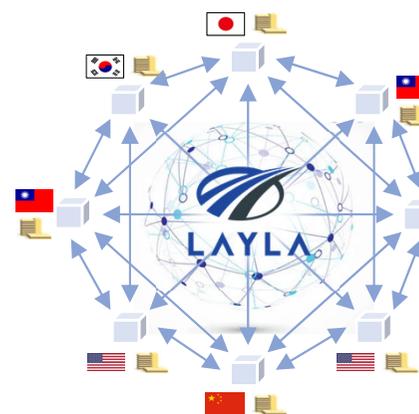
- 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせなければならないため、**必要な情報が限定される**
- 従来の調達方法では納品まで、**時間、コストがかかりすぎる**
- 調達ルートが限定されてしまうため、**独自に調達ネットワークを確立する必要がある**

老朽化した製造装置の部品調達が困難



LAYLA

商品数**31.5**万点超



世界中の
点在している
部品を集約

- **実在庫を24時間365日確認可能**
- 可視化された実在庫の**価格、納期、保証期間、状態まで確認可能**
- TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが安心して購入できる環境を実現(安心保証)

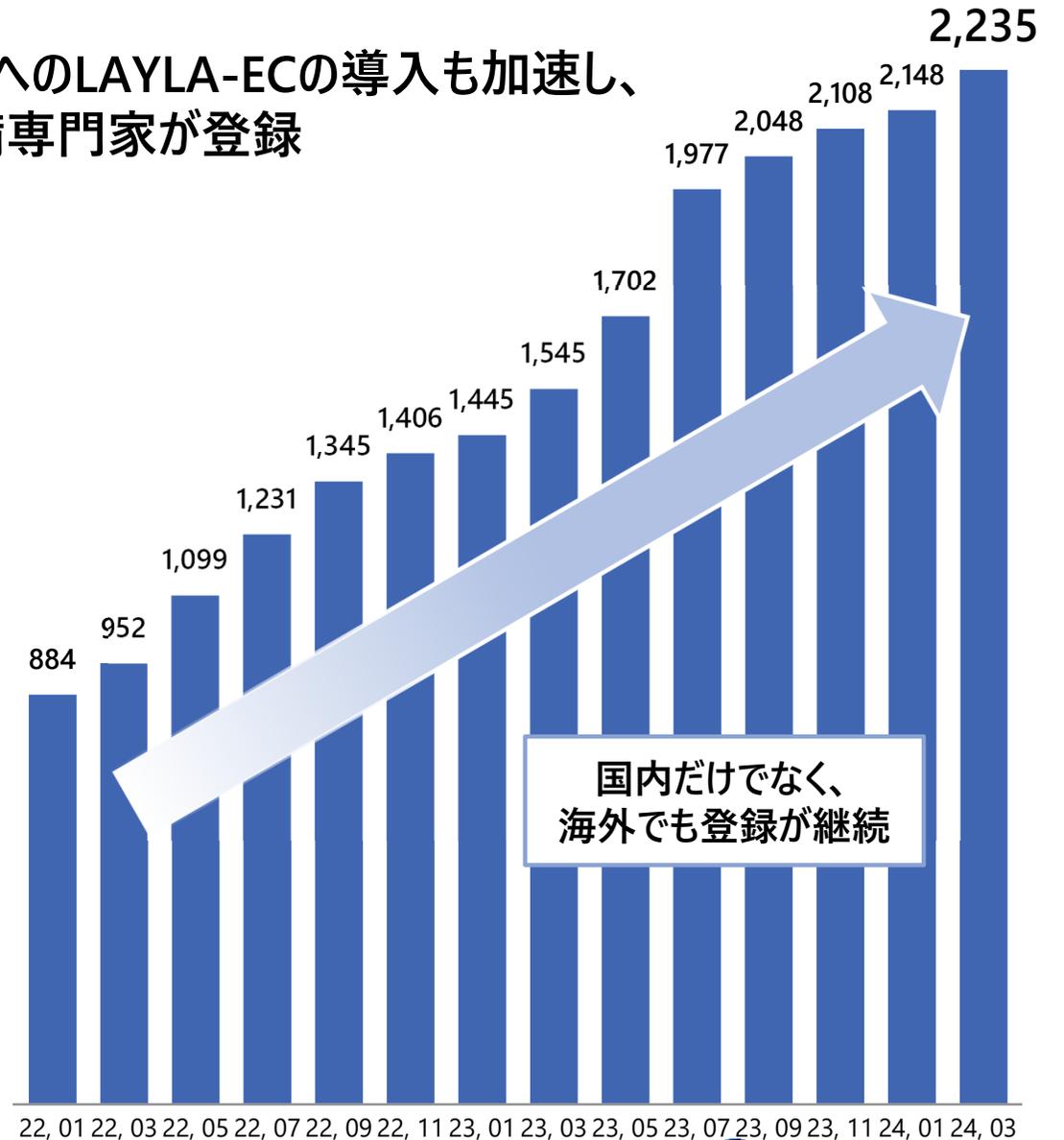
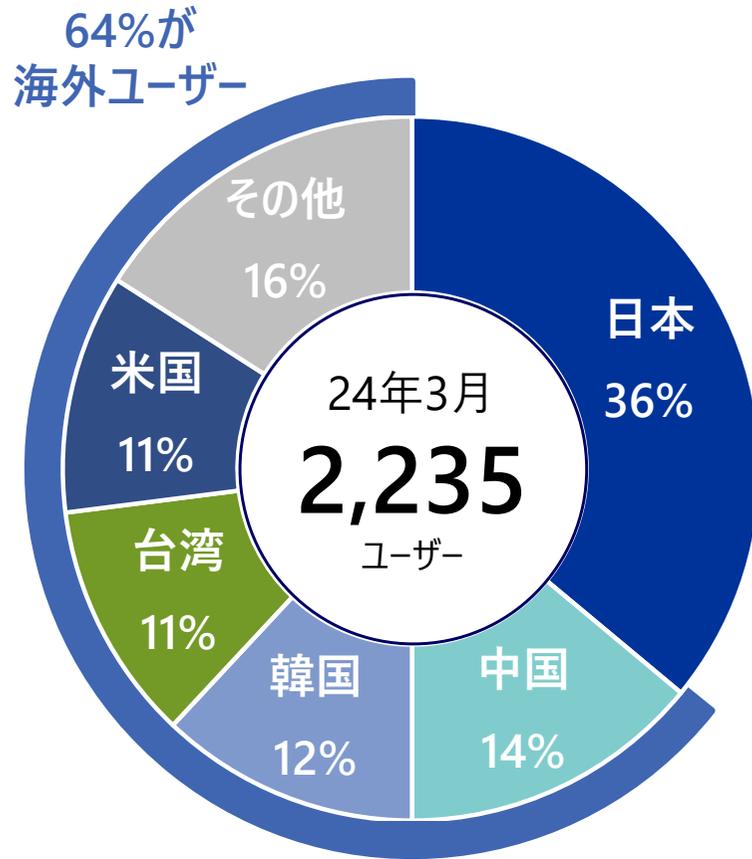
半導体工場のDX化に貢献

1 継続的に成長するLAYLA-ECのユーザー数

LAYLA-ECのユーザー数は拡大傾向、主要ユーザーは日本、一方で海外のユーザーも多く登録

ユーザー登録数推移

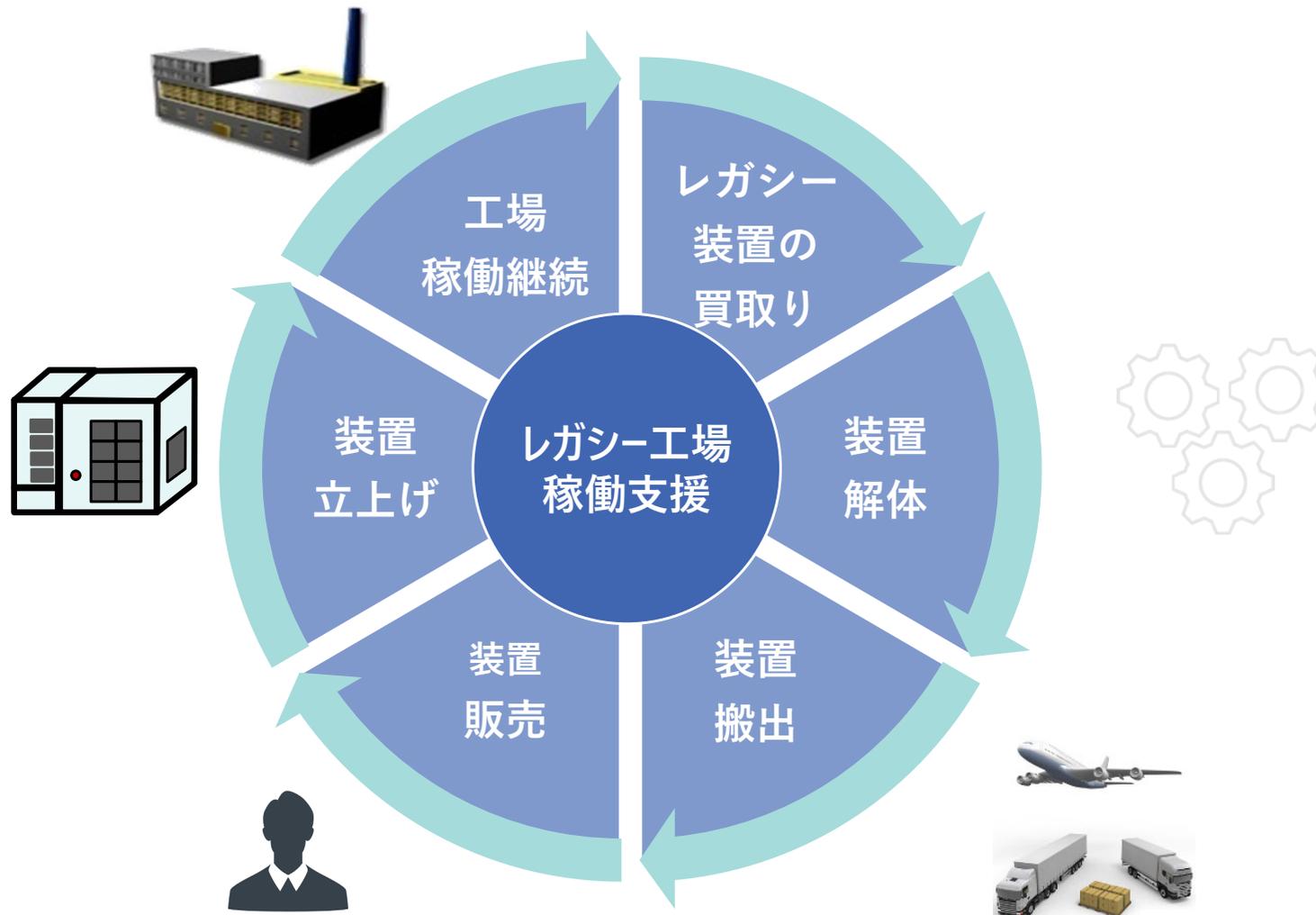
国内半導体工場へのLAYLA-ECの導入も加速し、多数の調達・設備専門家が登録



ユーザー数とは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数

2 エンジニアリング力を活用した装置販売サービス 半導体工場に稼働支援サービスを提供し、半導体工場から収益を得る

- 半導体装置の構成や部品の構造などを熟知したフィールドエンジニアが、エンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、歩留まり改善（CIP化等）、不要装置の買取など、顧客の課題に対して幅広いソリューションを提供
- 大手半導体メーカーから**Regional Supplier Recognition Awardを受賞**



2 Regional Supplier Recognition Award

世界中の12,000社のサプライヤーのうち、わずか20社のみが受賞対象、優れた技術を持つ証である

- 大手半導体メーカーに、中古の半導体製造装置を販売するだけでなく、立上げ及びプロセスチューニングを装置に施すことにより、大手半導体メーカーの生産性改善に大きく寄与し、結果として大幅なコストダウンに。

——— ハイレベルなプロセスチューニング・立上 ———

——— 顧客の品質・コストダウンに貢献 ———



装置の各種設定や動作を微調整し、製造する際の工程の最適化を実施

製品の品質向上

微細な構造や高い精度が求められる半導体チップにおいて、設定を最適化することでエラーや欠陥を減少

生産効率の向上

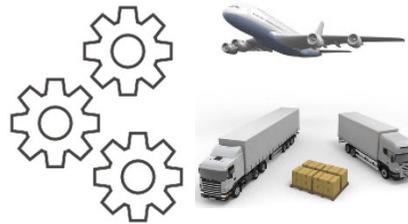
プロセスチューニングにより製造サイクルが短縮化、生産性が改善

歩留まりの改善

歩留まりが向上することで、生産される良品の割合が増加



調達



物流



販売

入札

売買契約

解体

輸出

検収

請求

無害化

シャットダウン

ケーブル・配管
取り外し内部コンポーネ
ントの解体

廃棄・分別

テクニカル
レポート**無害化**

ガスラインの遮断と排除
冷却液や他の流体の安全な排除

シャットダウン

装置からの電源切断
バックアップバッテリーの除去

ケーブル・配管取り外し

外部カバーの取り外し
配管やケーブルの取り外し

内部コンポーネントの解体

モジュールや部品の個別の取り外し

廃棄・分別

再利用可能材料の分別
有害物質の適切な処理
リサイクル廃材の適切な処分

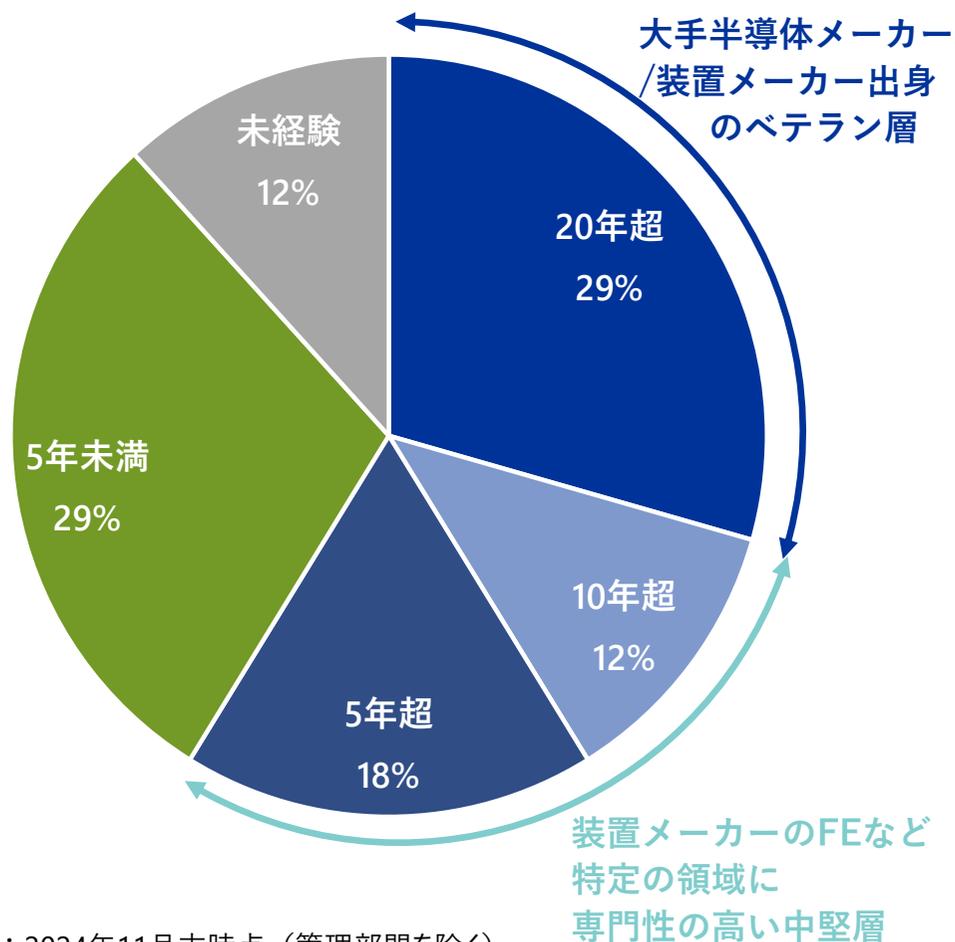
テクニカルレポート

作業の詳細な記録
インシデント報告

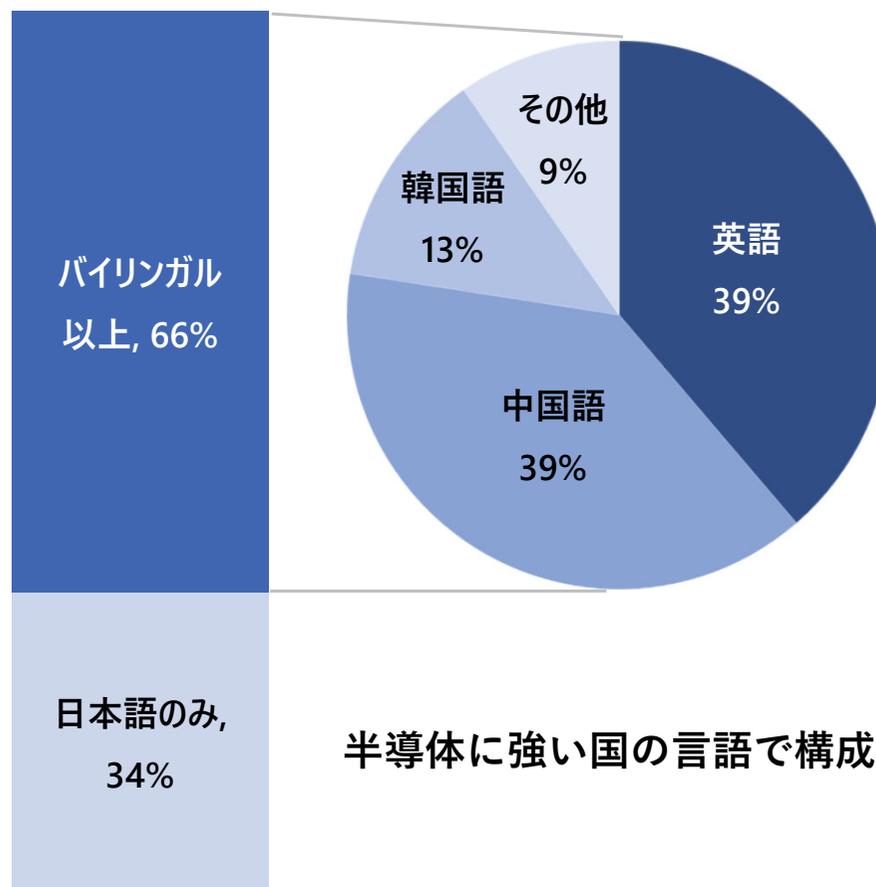
2 エンジニアリング力を活用した装置販売サービス 高度な知見と多彩なバックグラウンドを有した専門家チーム

- 当社は、中堅からベテランまでの半導体製造のプロフェッショナルが厚く在籍
- また社員の6割以上がバイリンガル人材で構成されており、現地の商慣習にも精通

半導体業界の在籍年数



社員の言語別構成比



出所：2024年11月末時点（管理部門を除く）

AGENDA

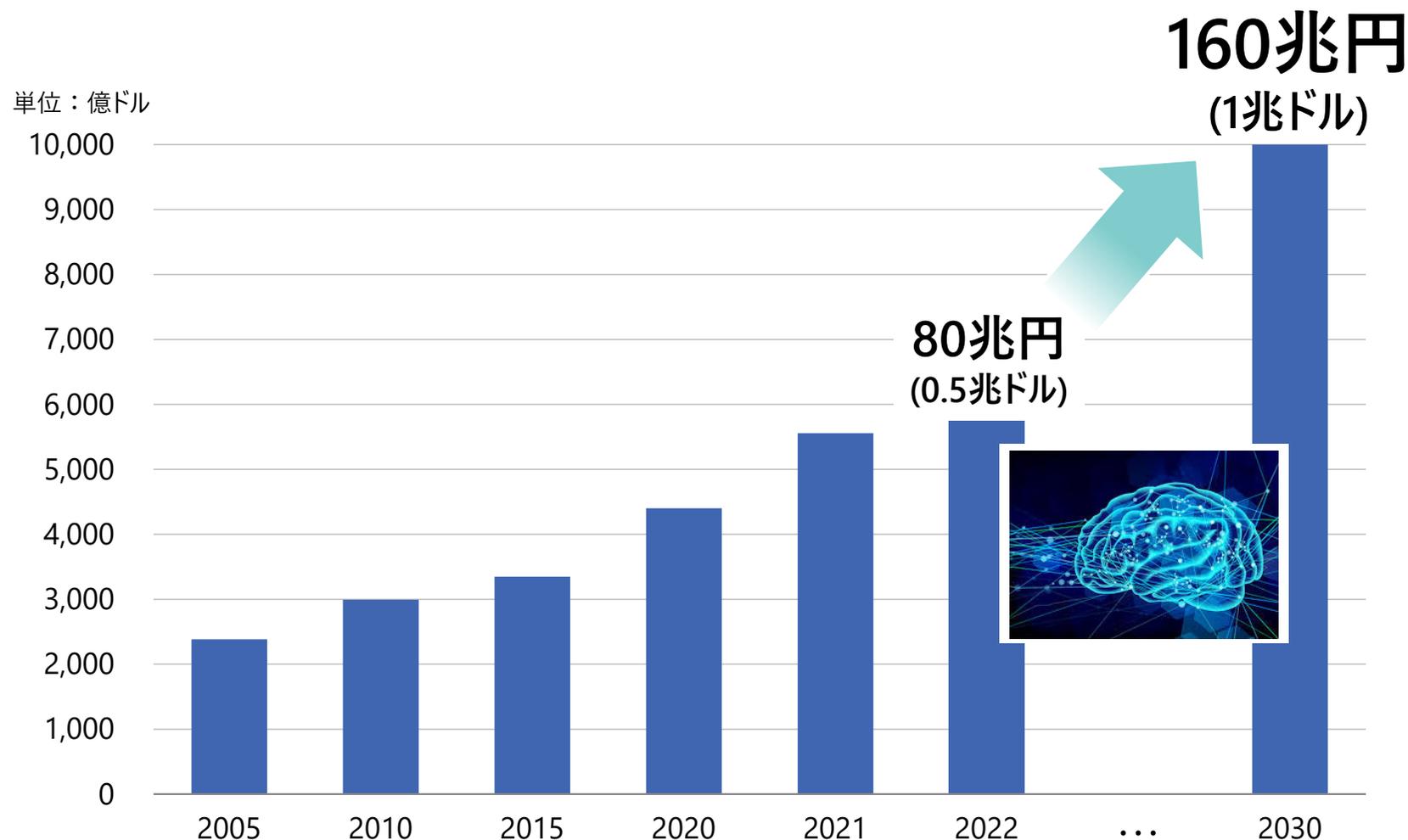
- 01 会社概要
- 02 事業内容
- 03 市場環境
- 04 競争優位性
- 05 成長戦略

世界の半導体市場規模

2030年には全世界の市場規模が160兆円にも成長することが見込まれている

- AI、5G、電気自動車、量子コンピュータ、あらゆるテクノロジーに半導体は使われており、半導体の用途は多様化し、近年市場が急激に拡大

世界の半導体市場予測



出所：SEMI, May 9, 2022 ISS 2022: Semiconductor Industry Market Outlook and Prospects for Reaching \$1 Trillion by 2030
経済産業省 (2021.3.24) 「第1回半導体・デジタル産業戦略検討会議」、WSTS 2024年春季半導体市場予測

当社の事業背景 ～世界市場における旧型半導体製造装置の重要性～ 「最先端装置」だけではなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

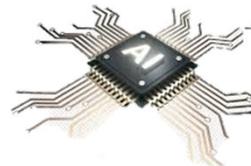
半導体市場の現状

半導体市場の投資動向 (対応の方向性)

最先端

AIや最新テクノロジーの進歩により、高性能な最先端半導体が必要とされ、半導体の進歩なしでは文明の進歩もないという状況

官民協力で、先端半導体開発に数兆円規模の投資が進んでいる（Chips法、経産省補助金、TSMC投資など）



旧型

IoT製品や電気自動車などの消費者に身近な製品が普及し、半導体の用途が多様化。
低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛。
20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働している状態である

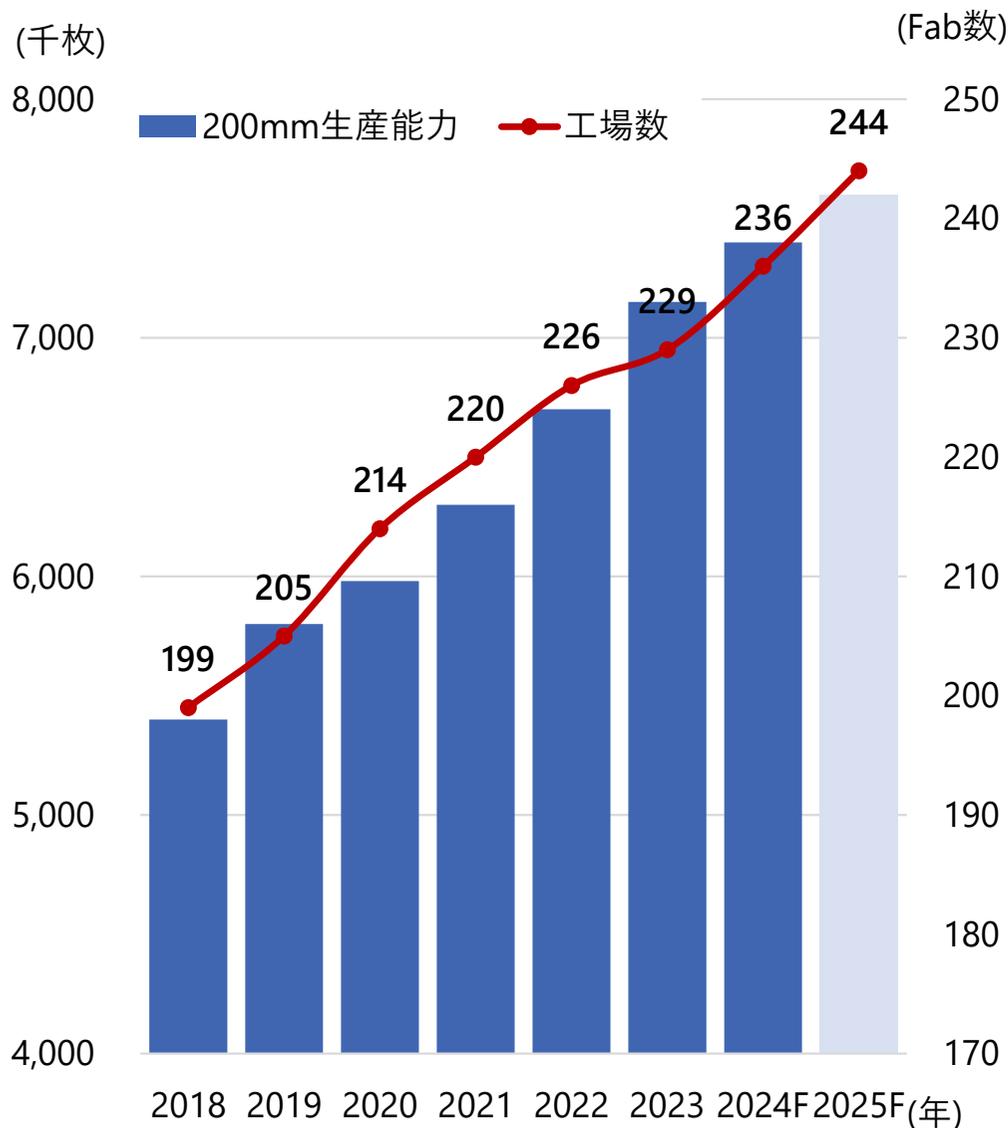
旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、装置の保守（EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対する投資がグローバルでなされている

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

当社の事業背景 ～レガシー半導体の旺盛～

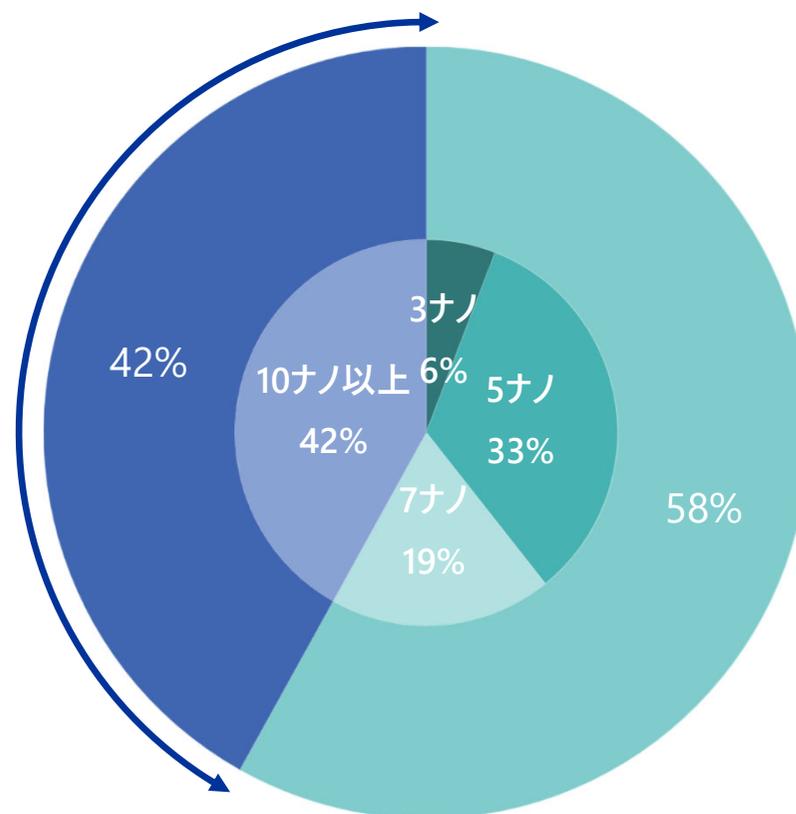
半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

200mmウエハーファブ数と生産能力推移



TSMCのプロセス別売上構成

売上の約42%が10ナノ以上
(最先端ではない)



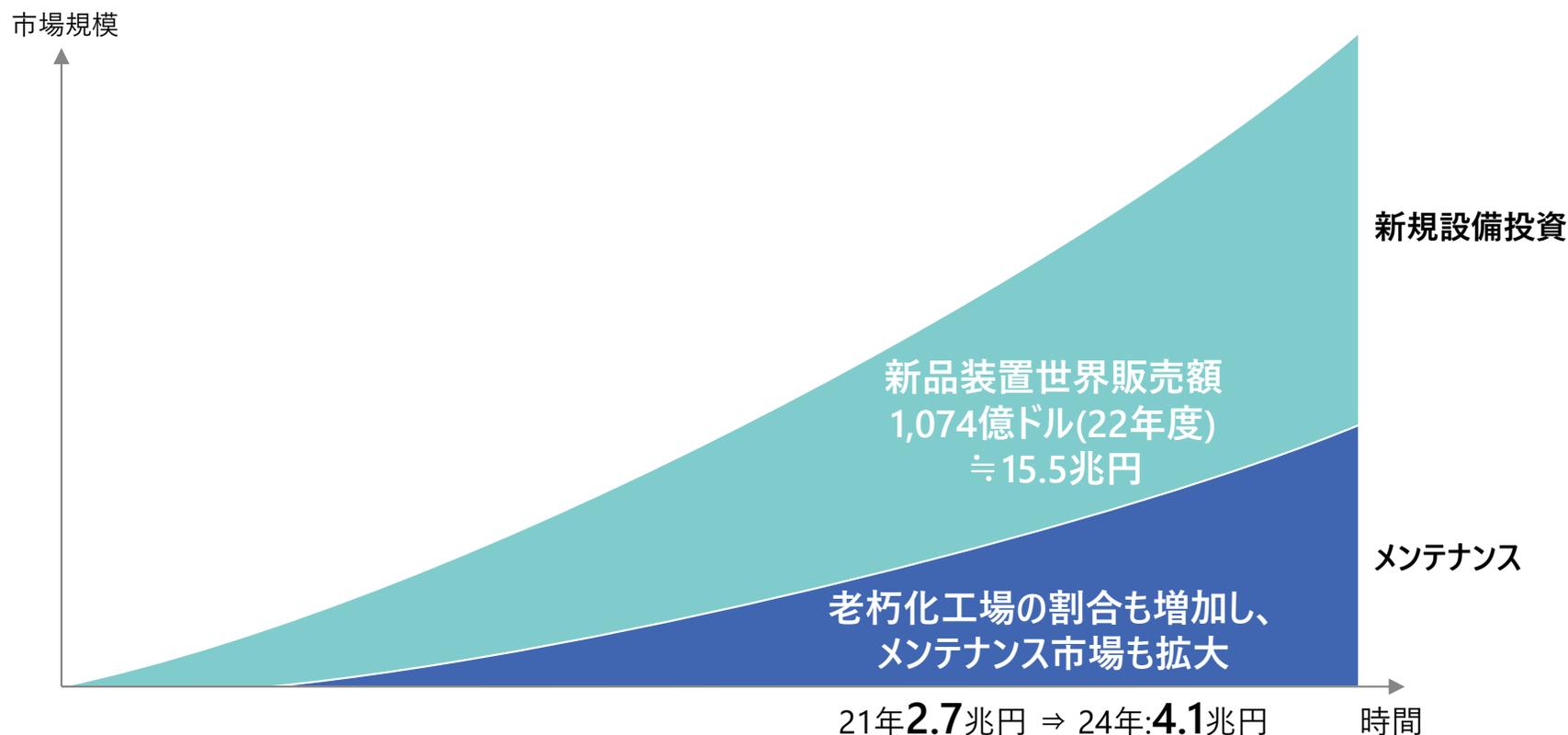
出所：SEMI 2024年9月25日発行、「世界の200mm半導体前工程ファブにおける生産能力の推移」

出所：TSMC 開示資料より抜粋
2023年度実績

当社の事業背景 ～メンテナンス市場（部品購入・修理等の保守）の拡大～ 新品・中古製造装置の増加とともに、装置稼働させるためのメンテナンス需要も拡大

- シリコンサイクルと言われる半導体業界の構造的な景気変動サイクルにより、投資に凸凹があるが、一方で世界の累積工場数は増え続けており、アフターマーケットは拡大し、半導体市場が拡大するなかで、部品の調達が困難に

新品装置とメンテナンス



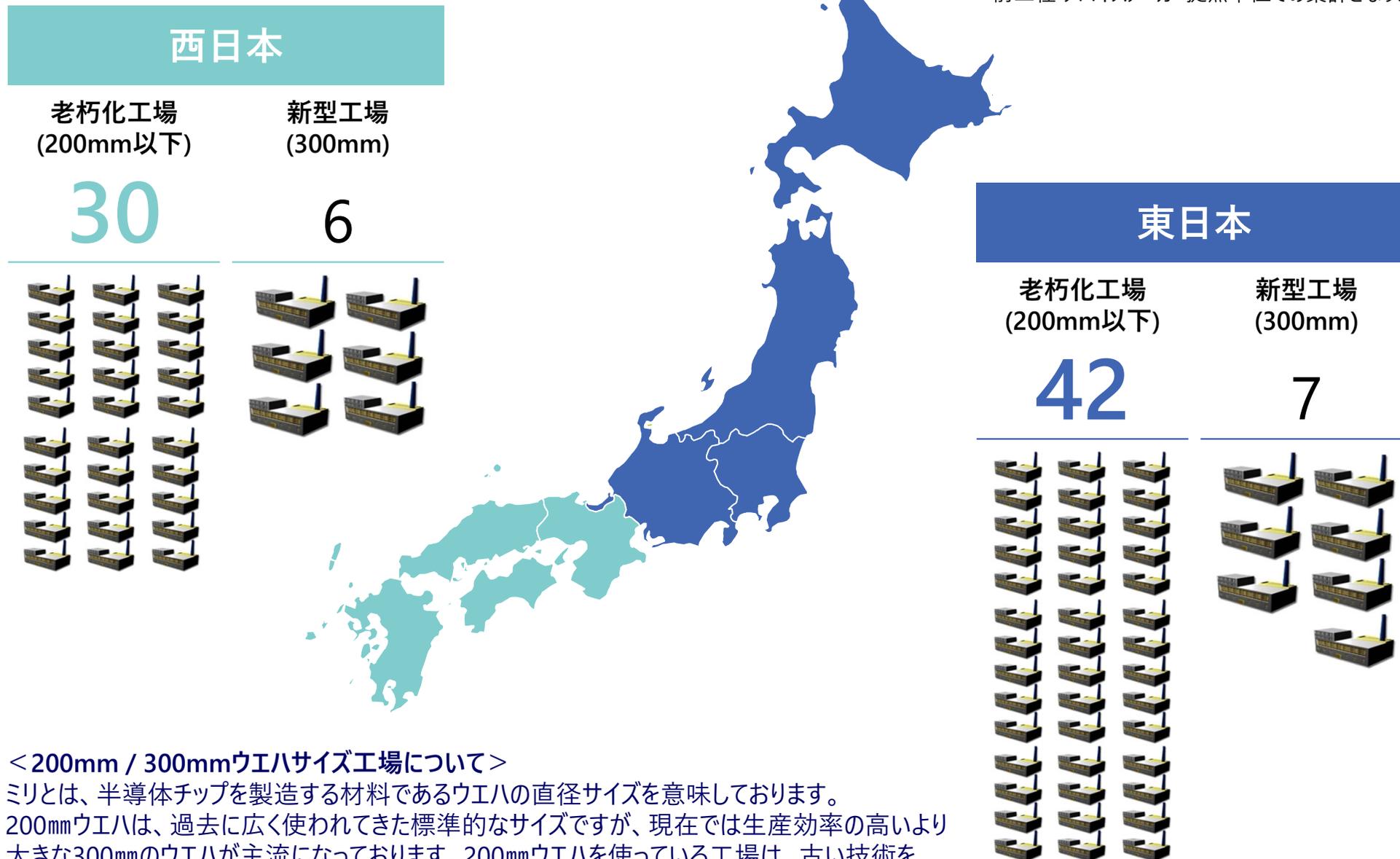
部品情報を集約した越境ECサイトとエンジニアリング力の両方が
社会に必要とされており、両方を満たせるのが当社の強み

(出所) メンテナンス（アフターサービス）の市場規模は、SEMI-NET, 半導体製造装置・ポストセールス市場年鑑より参照

国内半導体工場の現状 半導体工場の新旧比較

国内半導体工場の大半が20年以上前に建てられた200mm以下の工場である

出所：半導体工場ハンドブック2022に基づき作成
前工程 デバイスメーカー拠点単位での集計となります。



< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

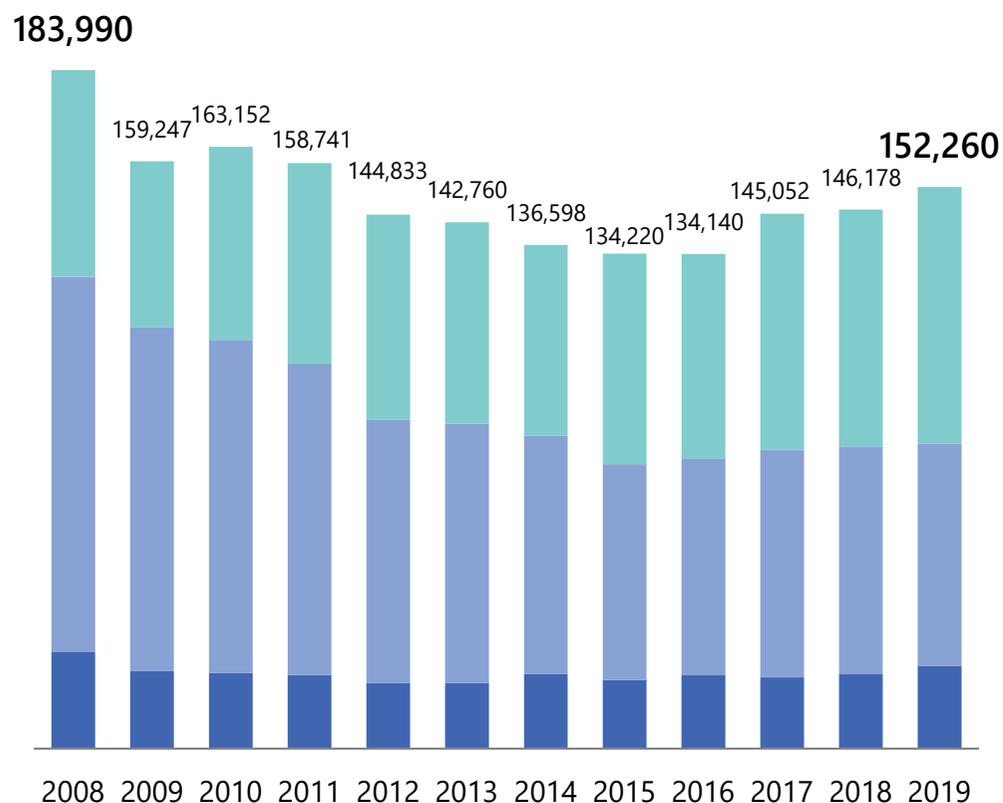
ミリとは、半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております。
200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております。200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります。

国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

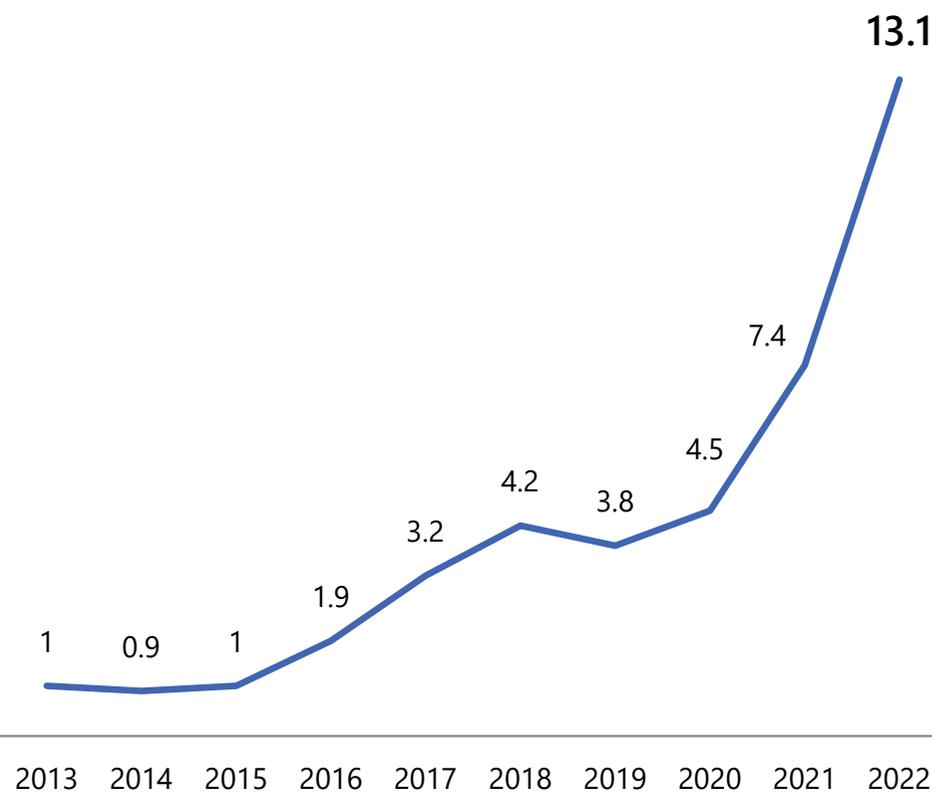
半導体業界は深刻な人手不足

- 工業統計調査(経済産業省)によれば、2008年に約18万人だった半導体は2019年には約15万人に迄減少
- その一方、半導体人材の需要は急速に伸びており、2022年は2013年比で13.1倍まで需要が加速
- TSMC（熊本）、ラピダス（北海道）、マイクロン（広島）など国内投資が加速

日本の半導体人材数



半導体関連のエンジニア求人倍率



■ 半導体素子製造業 ■ 集積回路製造業 ■ 半導体製造装置製造業

(出所) 経済産業省「経済センサス活動調査・工業統計調査_2-01_産業細分類別_年次 2005年 - 2020年」を基に当社作成

AGENDA

- 01 会社概要
- 02 事業内容
- 03 市場環境
- 04 競争優位性
- 05 成長戦略

競争優位性

トータルソリューションと強固な顧客基盤により参入障壁の高い半導体業界に深く参入

他社が模倣しにくい独自のポジショニングを確立し、強固な顧客基盤を確立

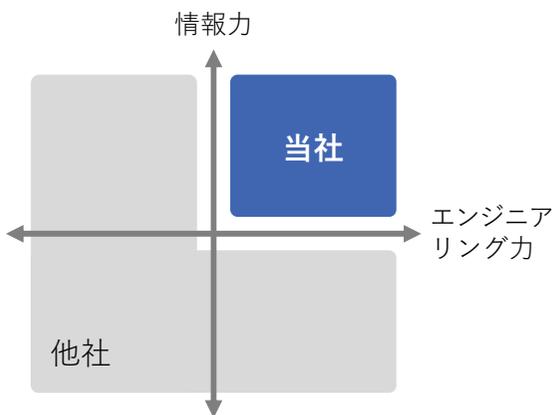
技術、知識ナレッジの蓄積

顧客との直接取引によって蓄積されるノウハウと課題解決力



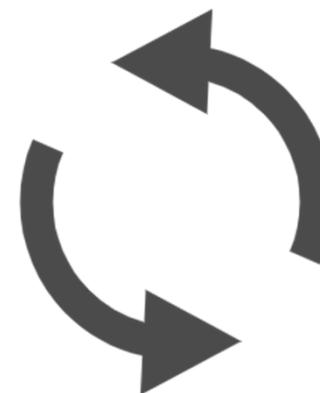
ポジショニング

ブルーオーシャンでニッチトッププレイヤーとしての市場を創造



高い継続性

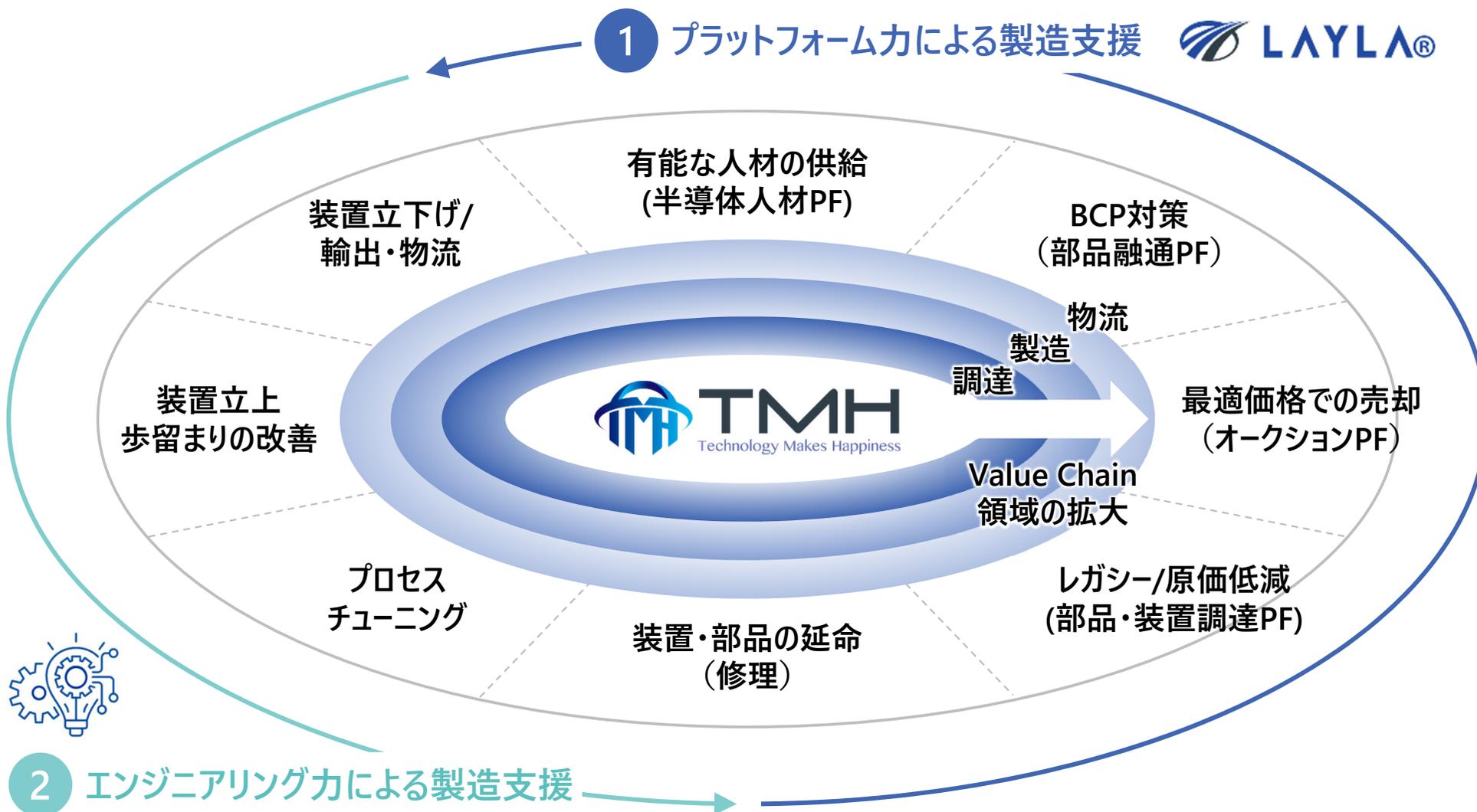
課題解決を通じて醸成された信頼関係が、追加、継続取引へつながる



技術・知識ナレッジの蓄積

半導体工場の多様な課題に対応することで、顧客にとっての唯一無二の存在に

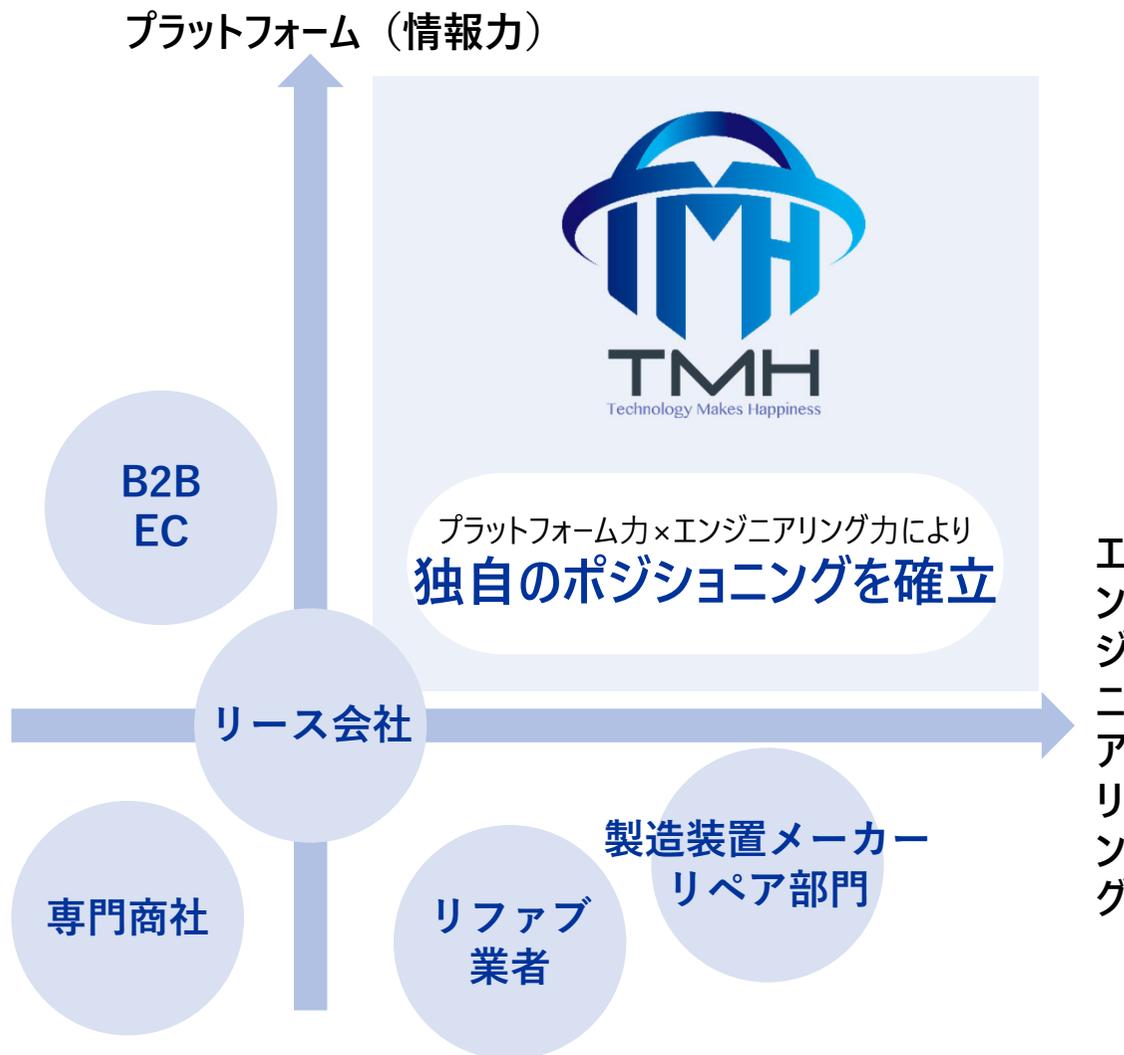
- 半導体工場の課題解決を通じて様々な案件に触れることにより、ノウハウや課題解決力が向上
- 半導体製造に関わる情報集約型企业として安定的な成長へ



ポジショニングマップ

独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

競合と当社の位置づけ



参入障壁

01 | vs リース会社、商社

- プラットフォームを活用したデジタルサービスを活用した情報力
- 半導体製造装置の立上げやプロセスチューニングといった高度な支援を提供

02 | vs 半導体製造装置メーカー

- 装置メーカーは先端工場に対して支援が厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く半導体工場を支援
- 装置メーカーは自社製品のみ取り扱うが、当社は全ての製造装置メーカーの商材を扱い、幅広いサービスラインナップを提供

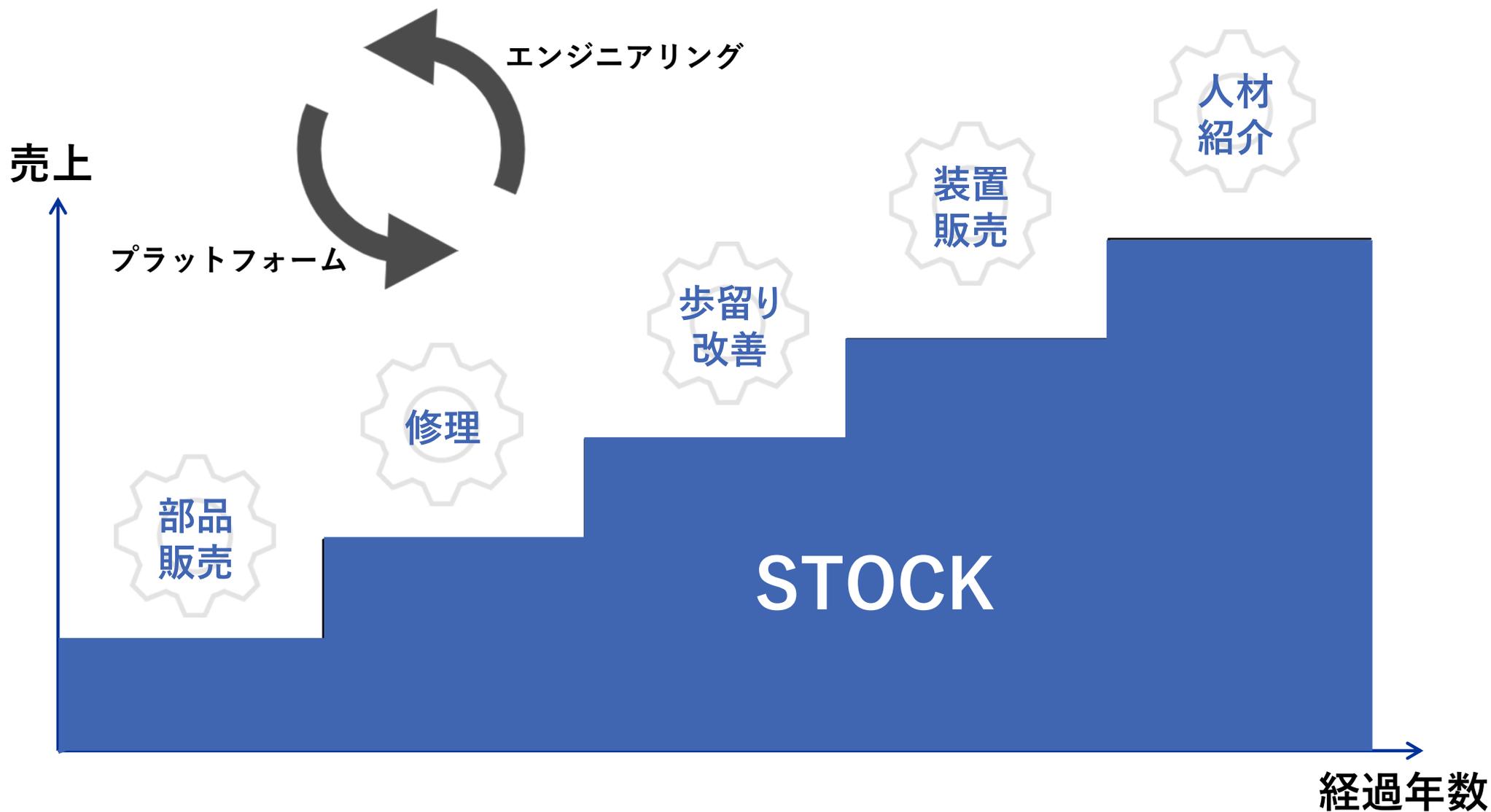
03 | vs 新規参入

- 半導体製造領域は技術的な知見を必要とし、また既に日本全国に顧客基盤があり多くのシェアを獲得していることから、参入障壁を高く保持することが可能

高い継続性

取引を通じて醸成された信頼関係が、その後の継続取引やビジネス多角化へ

- 半導体工場の課題解決を通じて、顧客との信頼関係を構築。既存顧客との取引拡大や利益率の高いアフターサービスへと繋がり、顧客との長期的な取引へとつながる。



AGENDA

- 01 会社概要
- 02 事業内容
- 03 市場環境
- 04 競争優位性
- 05 成長戦略

成長戦略イメージ

中長期的には、新規拠点設置、PF拡張、海外展開を視野に入れ事業拡大を狙う

売上高

25-30年 海外展開

25年以降、海外進出を本格化
インド、台湾への進出を皮切りに
世界規模でのポジショニングを確立

3
stage

25-27年 国内拠点拡大

重要顧客の工場稼働に合わせ、拠点を設置
新規顧客の開拓により、売上拡大を見込む

2
stage

25年11月期 人材PF事業

半導体業界に特化した人材PF事業開始
新規事業により新たなニーズを掘起こす

1
stage

達成済

24年1月～九州（熊本）支店開設
23年7月～LAYLA-Auctionリリース

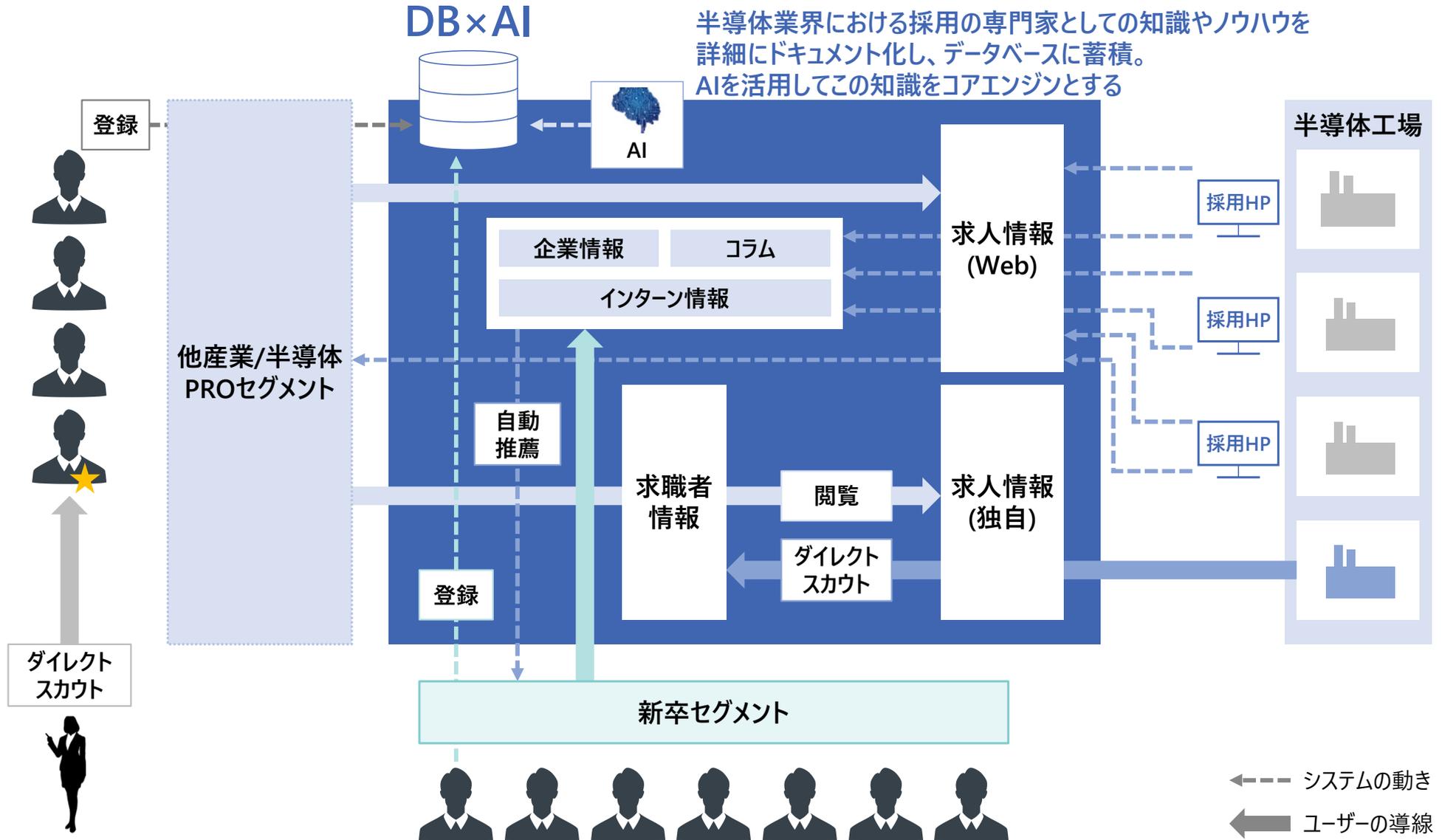
完



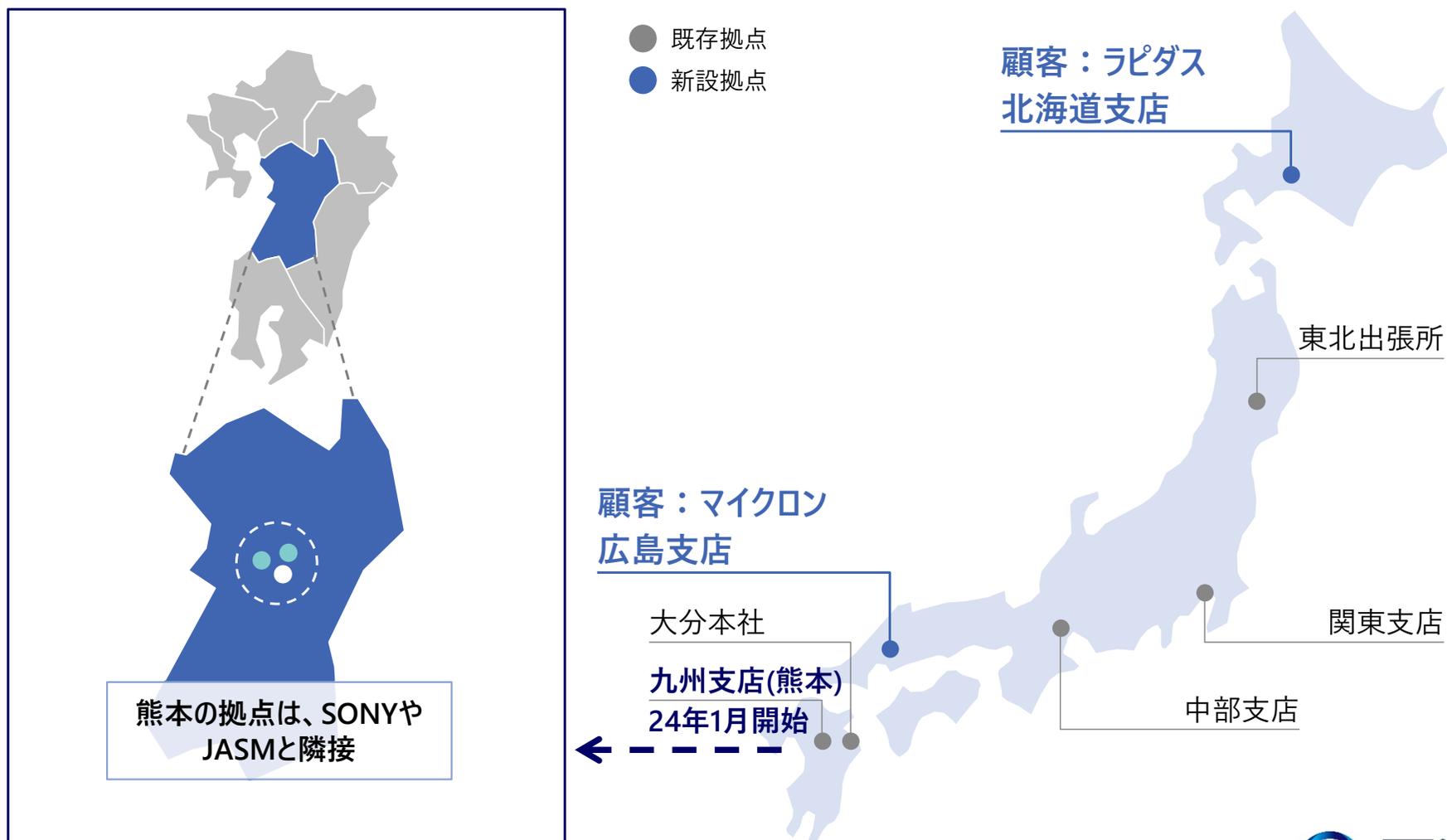
人材PF事業の推進 ～短期・中期計画 半導体人材PF LAYLA-HR～

半導体業界における人材不足の課題を解決するためのプラットフォーム構築を推進

半導体特化型人材プラットフォーム構想 (LAYLA-HR)

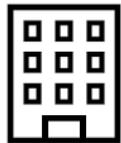
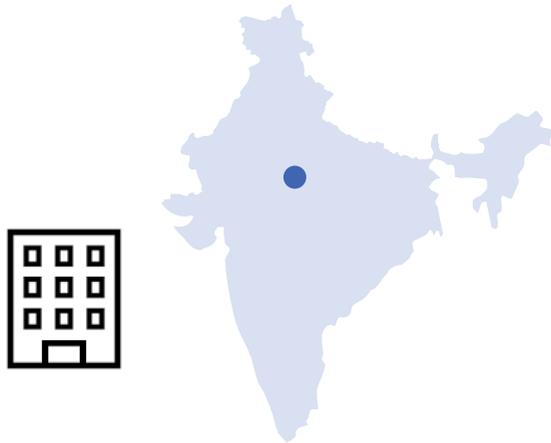


日本国内に大規模投資が行われるなか、 当社は重要顧客に隣接したエリアに営業拠点を設け市場拡大を狙う！



インド市場を **重点営業強化** エリアとして設定

ECを活用した部品販売や修理サービスから、装置販売先の顧客開拓までを日本と連携し対応

**潜在力**

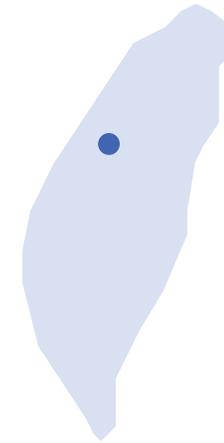
インドは国策として積極的に半導体製造工場の投資を実施、タタGrと台湾のパワーチップ（PSMC）共同による半導体ファブ建設予定もあり、旧型装置やメンテナンス需要も高い

戦略

2024年にインド顧客開拓を実施。セミコンインディアの出展を皮切りに市場拡大を狙う。中長期的には海外営業拠点の一つとして検討

台湾優良サプライヤーと協業し、台湾と **技術連携** を強化

リファブやメンテナンスレベルを昇華、技術力を柱に国内の半導体市場（特に熊本）の拡大を狙う



TSMCは日本国内に5つの工場建設を計画・検討、熊本で第1・第2工場の建設は確定。熊本TSMC（JASM）では、サプライヤーの50%を国内調達化する方針であり、参入余地がある

JASMをターゲットとし日本進出を目指すサプライヤー各社と技術連携し、当社の熊本拠点を要の営業拠点とし、営業攻勢を展開

中期的なマージンターゲット

新規事業、販路拡大により事業規模を拡大させながら、利益率向上を目指す

3年後（2027）のマージンターゲット達成のシナリオ

- 装置販売はシェア拡大を図りつつ、アフターサービスで付加価値を高め、利益率が向上
- 部品販売や修理サービス（内製化含む）展開により、利益率の大幅な改善
- 人材紹介サービスは高い粗利率を持ち、マッチングプラットフォーム化によりさらに利益率が向上



売上総利益率目標

25%

マージン拡大のための施策

- これまでの実績に基づくさらなる大型案件の受注
- プラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスや人材紹介サービスの事業成長により収益性が向上

営業利益率目標

15%

マージン拡大のための施策

- 売上の拡大に伴い販管費率低下
- 大規模工場の近隣に拠点を展開し、ソリューション営業を展開することにより、収益性の高いビジネスを実現するとともに、効率化を追求することで成長期においても経費削減を実現

02 2024年11月期 通期業績ハイライト

2024年11月期 通期 業績サマリ 前年実績対比

FY2024は業績好調、予算の上方修正を経て、YoYで大幅な営業利益増へ

売上・利益ともに大幅に伸長し、業績が大きく改善。2024年11月期の決算はエンジニアリング力による装置販売ビジネスが好調で、前年対比で売上高は244%増の成長となった

(単位：百万円)

	通期				差異理由
	FY2023 実績	FY2024 実績	YoY 増減額	YoY 増減比率	
売上高	1,747	6,017	4,270	244%	・ エンジニアリング力による装置販売が伸長
売上総利益	340	862	521	153%	・ 売上の絶対額が増加したことにより前年対比で売上総利益額が増加
営業利益	△127	323	450	-	・ 販管費増加、一方で売上総利益が増加したことで営業利益も増加
営業利益率	△7.3%	5.4%	12.7%	-	・ 営業利益黒字化により改善
経常利益	△353	306	659	-	・ 為替の影響を最小限に抑え、改善
当期純利益	116	272	155	134%	・ 営業利益・経常利益増加に伴い、当期純利益も改善

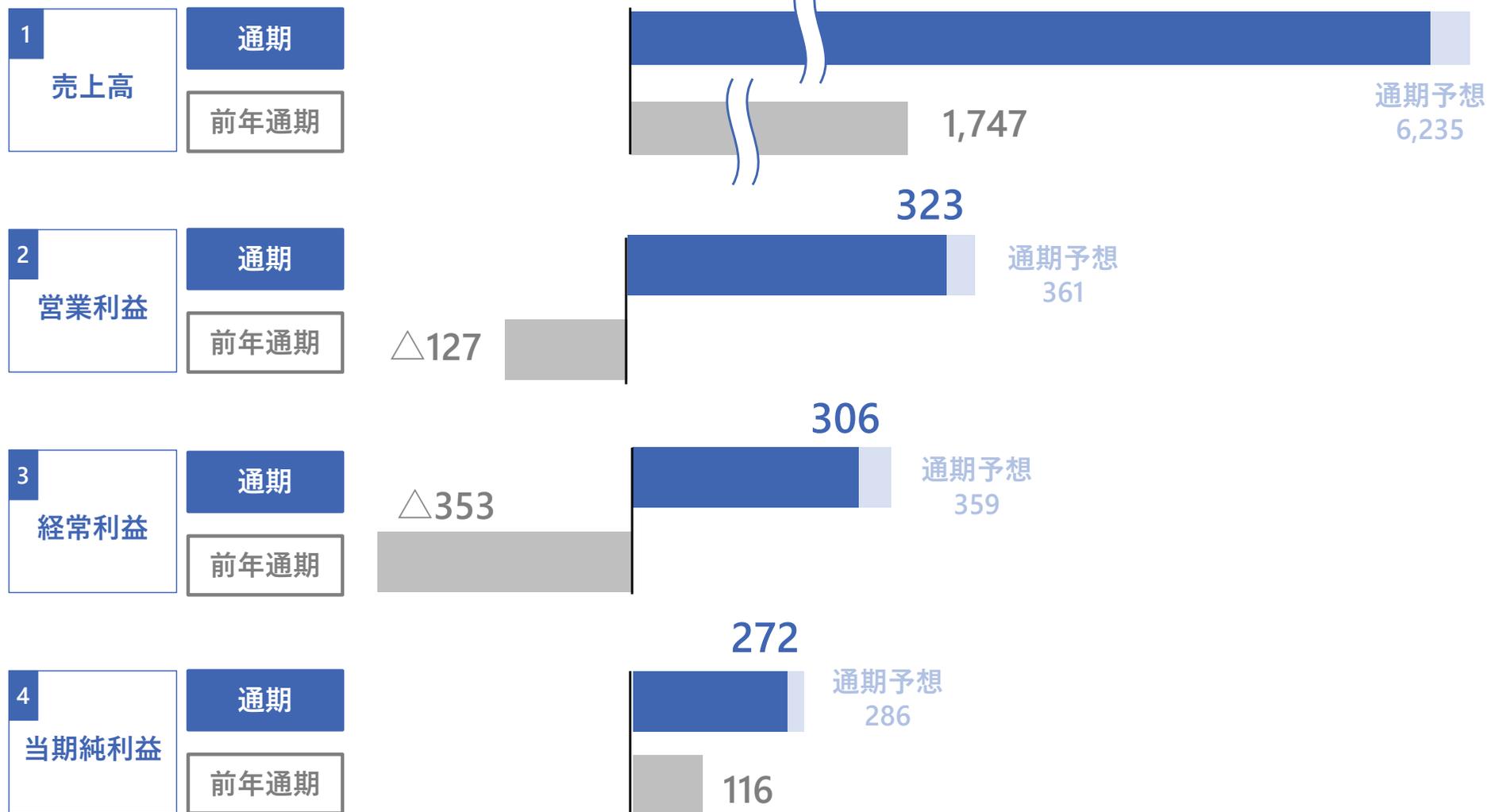
FY2023実績の営業利益がマイナスになっているため、FY2023の営業利益率は、わかりやすさを考慮して絶対値における比較により表示しております

業績予想に対する進捗率

上方修正後予算に対しては、96.5%の進捗。概ね業績予想通り

一部、装置案件が25年11月期にずれ込んだことにより、トップラインが96.5%の達成率に留まった

(単位：百万円)



費用内訳

売上増加に比例し、利益額が増加、同時に売上原価も増加

装置販売のシェア拡大に伴い、プロダクトミックスの変化に伴い、全体的に原価率が上昇傾向一方で、売上拡大に比例して固定費増加幅は中長期的に改善する見込み

(単位：千円)

	FY2023	FY2024	YoY 増減率	YoY 増減額	主な理由
売上高	1,747,118	6,017,239	244%	4,270,121	
売上原価	1,406,332	5,154,591	267%	3,748,258	
商品原価	1,250,635	4,799,671	284%	3,549,035	・装置販売の売上拡大による仕入増加
労務費	49,084	66,585	36%	17,501	・エンジニアリング職員の増加等
外注費	71,506	255,545	257%	184,038	・装置販売の売上拡大による外注増加
経費	35,106	32,789	-7%	△ 2,316	
販管費および一般管理費	468,074	539,049	15%	70,975	
人件費	288,436	321,738	12%	33,301	・役職員の増加等
採用教育費	27,090	21,232	-22%	△ 5,858	・前期 幹部社員の採用活動費の増加等
業務委託料	34,445	34,503	0%	58	
管理諸費	9,554	22,279	133%	12,725	・監査報酬の増加等
旅費交通費	24,255	32,256	33%	8,000	・海外販路拡大、営業活動拡大による増加等
貸倒引当金繰入額	△ 8,154	0	-100%	8,154	
その他販管費	92,445	107,038	16%	14,593	・減価償却費の増加等
営業利益	△ 127,288	323,598	-	450,887	

貸借対照表

大型案件の前受金の増加や売上拡大に伴い、現金及び預金は大幅に増加

営業活動によるキャッシュイン、顧客からの前受金により現金預金がさらに増加
IPOによる資金調達により資金力が増加したことにより、未来への投資が可能に

(単位：千円)

	FY2023 4Q末	FY2024 4Q末	YoY 増減額	特筆事項
流動資産	1,581,556	3,551,839	1,970,282	・営業活動によるキャッシュフローの増加等により現金預金が増加
現金及び預金	1,074,636	2,562,456	1,487,820	
固定資産	115,730	265,344	149,614	・熊本の土地建物の取得に伴い固定資産が増加
総資産	1,697,287	3,817,184	2,119,896	
流動負債	1,008,255	2,861,694	1,853,438	・買掛金および翌事業年度以降の売上高に寄与する契約負債が増加
買掛金	377,136	803,513	426,377	
契約負債	505,466	1,748,807	1,243,340	
固定負債	179,770	173,724	△ 6,046	
純資産	509,262	781,766	272,504	・当期純利益の計上による利益剰余金の増加

KPI

継続的に業績の見通しが明るく、生産性も改善傾向

FY2025以降に貢献する受注高が安定的に積み上げられており、業績の見通しが明るい
装置販売サービスが大きく成長

(単位：百万円)

KPI		FY2023 末時点	FY2024 末時点	YoY 増減率
未来の業績に関する指標	受注残総額	4,803	6,230	30%
過去の業績傾向に関する指標	(越境ECプラットフォーム) 部品販売・修理サービス売上高	936	902	-4%
	(エンジニアリング) 装置販売サービス売上高	810	5,109	531%
生産性に関する指標	従業員一人当たり売上高	49	154	209%
	従業員一人当たり当期純利益	3	6	110%

受注残とは受注契約から将来に期待される収益の総額を意味しております。つまり、受注残が積みあがることは将来の業績への寄与が見込まれることになります。

03 2025年11月期 通期業績予想

SEIZE THE FUTURE

FY2025は「SEIZE THE FUTURE」を目標に、シェア拡大と新規事業への積極的な取り組みにより
業界の地位を確立する目標を設定！「未来を創る」と同時に「市場を奪取する」

FY2025事業方針

シェア拡大によりメンテナンス業界の地位確立

- ・岩盤事業の安定成長（越境ECプラットフォーム等を活用した部品販売・修理サービス）
- ・規模拡大によるシェア拡大（エンジニアリング力を活かした装置販売サービス）

新規事業推進による「未来創造」

- ・グローバル企業とのアライアンス強化による海外販売力及びエンジニアリング力の向上
- ・新たなプラットフォーム事業開始による半導体産業への貢献

基盤構築による効率化推進

- ・AI活用による生産性の向上
- ・業務改善に関わる社内システムの導入

通期業績予想

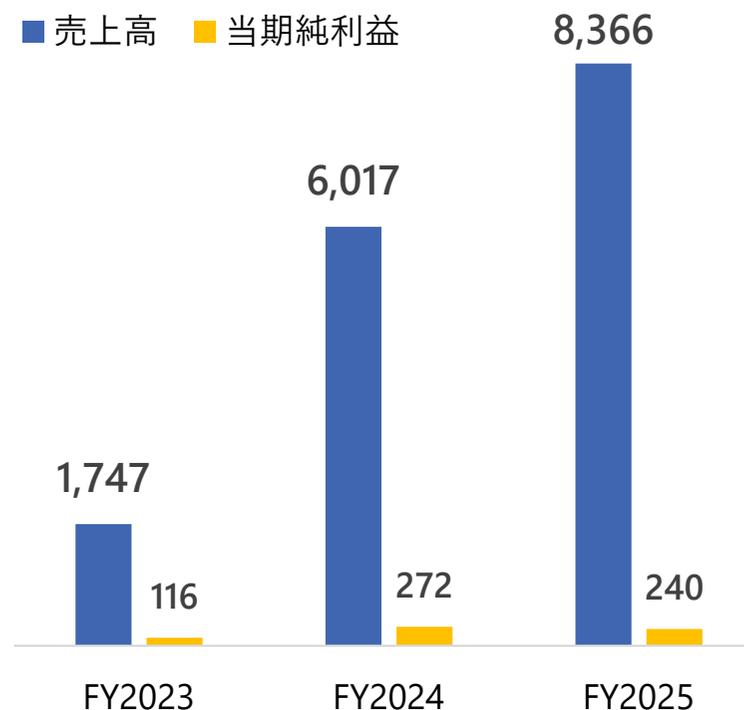
外部環境への適応、内部環境の変革により、売上高、経常利益ともに過去最高を目指す

装置販売サービス及び部品販売・修理サービスの増加により
FY2025売上高は83.6億円（YoY +39%）、経常利益は3.5億円（YoY+16%）と予想

AI半導体市場の拡大、キオクシア上場、JASM(TSMC)竣工など明るいニュースがある一方、中国半導体市場の投資抑制など濃淡のある市場環境のある中、海外企業との提携によるエンジニアリング強化や新たなプラットフォームLAYLA-HR稼働により事業強化を目指す

(単位：百万円)

	通期				
	FY2024 実績	FY2025 下限	FY2025 上限	YoY 増減額	YoY 比率
売上高	6,017	7,871	8,366	+2,349	+39%
営業利益	323	296	366	+42	+13%
経常利益	306	286	356	+50	+16%
当期純利益	272	192	240	-31	-12%



FY2025年の上限値は、当社の想定する年間業績予想となります。下限値は、2025年11月における大型案件の売上が翌期にズレた場合における下限値となります。

業績予想の前提

(単位：百万円)

売上高	8,366 ~ 7,871	
装置販売	6,823 ~ 6,328	<ul style="list-style-type: none">装置販売サービスの上限値は、受注残を基にFY2025の売上見込みを作成しております。下限値は、期末最終月の案件が翌年にズれたことを前提として試算しております。
部品販売・ 修理サービス	1,535	<ul style="list-style-type: none">部品販売・修理サービスは、前年実績および営業活動進捗に基づき試算しております半導体工場の稼働が増加することで売上も増加する特性があります。
売上原価		<ul style="list-style-type: none">装置販売の利益率により、売上原価及び部品販売・修理サービスの販売額に応じて原価率が変動します。
販売費及び一般管理費		<ul style="list-style-type: none">前年実績及び増加人員や展開計画にあわせて費用を試算しております。
営業外損益		<ul style="list-style-type: none">FY2024より基本的に装置販売サービスのような大型案件は円建て取引とすることで為替リスクを極小化しています。また、部品販売・修理サービスは外貨建て取引があるものの、売上計上と入金及び仕入計上と支払のタイミングが近いいため、影響は軽微なものとして想定しております。

本資料の取扱いについて

本資料は、株式会社TMH（以下「当社」といいます。）の企業情報等のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の投資勧誘等を目的としたものではありません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としています。本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら将来の見通しに関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。

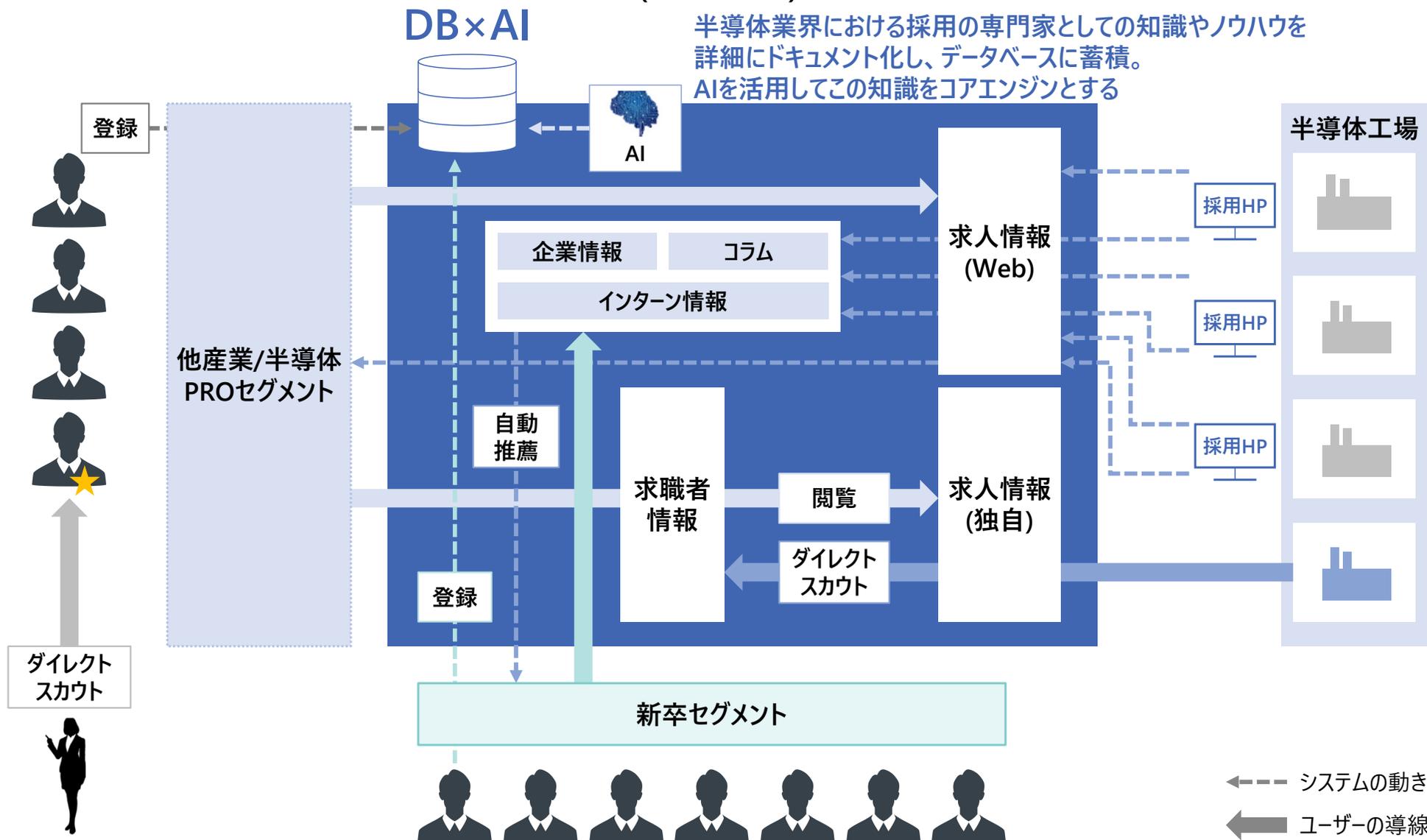
このような将来予測に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。

Appendix

APPENDIX：新規事業の推進 ～短期・中期計画 半導体人材PF LAYLA-HR～ 半導体業界就職に関わる情報、専門的なコラム、企業研究などのニーズを満たすPFを構築

半導体特化型人材プラットフォーム構想 (LAYLA-HR)



APPENDIX：新規事業の推進 ～短期・中期計画 半導体人材PF LAYLA-HR～ プラットフォームを活用した1st stepとして、半導体特化型人材紹介サービスを展開

